

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-004

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024 年度业绩快报公告

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024 年度主要财务数据和指标

单位:元、股、元/股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	953,942,795.24	828,855,419.07	15.09
营业利润	174,680,135.56	194,736,209.21	-10.30
利润总额	176,008,666.72	195,031,272.32	-9.75
归属于母公司所有者的净利润	164,897,334.86	179,305,770.17	-8.04
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	155,540,902.06	157,908,109.95	-1.50
基本每股收益(元)	1.25	1.43	-12.59
加权平均净资产收益率	7.79%	12.17%	下降4.38个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)

总资产	2,787,464,431.22	2,480,473,001.97	12.38
归属于母公司的所有者权益	2,066,803,653.22	2,031,690,393.13	1.73
股本	131,740,716	131,419,086	0.24
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	15.69	15.46	1.49

注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2024 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入 95,394.28 万元，同比增长 15.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,489.73 万元，同比下降 8.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,554.09 万元，同比下降 1.50%；基本每股收益为 1.25 元每股，同比下降 12.59%；报告期末，公司总资产 278,746.44 万元，较期初增长 12.38%；归属于母公司的所有者权益为 206,680.37 万元，较期初增长 1.73%。

2024 年度公司展现出了强劲的经营势头，在 PCB 及泛半导体领域持续发力，海外市场拓展、产品升级等方面取得了重要突破。报告期内，公司紧密围绕战略方向，精准捕捉行业升级和国产替代机遇，推进 PCB 设备升级，不断丰富泛半导体产品矩阵，推进直写光刻技术应用不断深化。同时，加速推进品牌全球化发展策略，加快布局东南亚市场，以优良的品质和服务积极拓展海外市场，进一步提升产品全球市占率以及品牌影响力。

营收方面，全年收入经营情况展现出稳步增长态势，核心业务板块 PCB 业务与泛半导体业务协同发力。2024 年第四季度，部分机台存在延迟发货，导致 2024 年年末存货金额大幅增加，进而造成四季度收入环比下滑；利润方面，综合全年来看利润受到一定程度的压力，主要原因在于海外市场的战略布局以及核心人才的储备和培养，市场开拓费用和人员费用随之增加。报告期内，公司积极拓展海外市场，建设海外销售及运维团队、泰国子公司投资建厂等环节需要大量资金投入，包括场地租赁、设备购置、人员招聘与培训等费用，增加了运营成本。同时，报告期内公司员工数量增长显著，薪酬、福利、培训等支出相应增加，人力成本上升明显。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日